

## 第8回 電子デバイス実装研究委員会プログラム

日時:平成 26 年 12 月 2 日(火) 10:30~16:15  
 場所:自動車会館 大会議室(2F) (東京都千代田区)

時間	題 目	講 演 者
	司会 柴崎 正訓 ((株)タムラ製作所)	
10:30~ 12:00	『Sn-Ag系PbフリーはんだとAu/NiPめっき基材との熔融時の界面反応 - Auめっき厚が界面構造に及ぼす影響 - 』 (45分)	(株)東レリサーチセンター ○伊藤 元剛 大阪大学 *現 ソニー(株) 平森 智幸、 大阪大学 廣瀬 明夫
	『高密度実装対応リワークにおける加熱技術の開発』 (45分)	富士通アドバンステクノロジー(株) ○佐藤 稔尚、岡田 徹、古川 稔、 増山 卓己
12:00~ 13:00	昼 食 休 憩	
13:00~ 13:10	委 員 会 議 事	
	司会 三谷 進 (ニホンハンダ(株))	
13:10~ 14:40	『次世代パワー半導体用接合技術』 (45分)	大同大学 ○山田 靖
	『Sn-Ag-Bi-In系合金の耐熱疲労特性向上に関する研究』 (45分)	パナソニック(株) ○日根 清裕、酒谷 茂昭、森 将人、 古澤 彰男
	休憩(5分)	
	司会 作山 誠樹 ((株)富士通研究所)	
14:45~ 16:15	『ガラスインターポーザーの開発と実装』 (45分)	新光電気工業(株) ○森 健一、小泉 直幸、村山 啓、 相澤 光浩、永井 鉦治、小山 利徳、 田中 正人、小平 正司
	『三次元半導体実装』 (45分)	法政大学 ○山田文明

( )内時間は、質疑応答時間を含む  
 ※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。